**浪潮信息TS860M5服务器**

为关键应用而设计



浪潮信息TS860M5是基于全新一代英特尔® 至强® 可扩展处理器平台的8路服务器产品，以其超强的计算性能，全面的可靠性设计和超高的性价比，为客户关键业务应用而设计，非常适合对性能和稳定性要求较高的关键行业，如金融、能源、政府、大型企业等，适用于虚拟化整合、大型交易数据库、内存数据库以及ERP等应用场景。

**产品特性**

**极速计算性能**

最大支持8颗全新一代英特尔® 至强® 可扩展处理器，主频最高可达3.8GHz，具备39MB大容量三级缓存，最多224个物理核心，448个线程，为用户提供强大的并行计算处理能力。

与第一代英特尔®至强®可扩展处理相比，升级后TS860M5的计算性能提升超过20%，内存带宽最大提升20%、充分满足大型交易数据库、内存数据库、虚拟化整合、大型ERP、高性能计算等关键应用。

**模块化灵活设计**

IO模块化设计，支持全高及半高两种IO模组，可根据客户对于IO扩展性的不同需求灵活搭配。

硬盘模组模块化设计，最大可支持24块3.5寸硬盘，可选支持12个NVME硬盘，针对SAP HANA的场景最大还可以提供50块2.5寸盘配置。

全模块化设计，可针对各个模块独立操作、灵活选择

**全方位容错设计**

TS860M5产品整机RAS特性80余项，实现全模块化容错设计，非常适合对于可靠性要求较高的关键业务应用。

PCIE外插卡支持单卡热插拔，最多可支持12个PCIE外插卡的单卡热插拔操作；电源模块支持N+N/N+M冗余，支持冷热冗余模式，可实现毫秒级切换；系统风扇支持N+1冗余；

BIOS ROM支持模块冗余；BMC双镜像冗余；可选支持全局时钟冗余，无缝切换时钟源；覆极小概率故障

**多维故障诊断**

系统配置OLED显示屏，可用于查看服务器资产信息、查看并设置管理IP地址、监控整机功耗及运行环温、显示信息故障码等；

处理器、内存支持离线光通路诊断，可帮助快速定位故障部件；

嵌入式示波器，硬件深层诊断分析，可记录并分析故障信号，迅速定位问题根源；软件层代码级诊断器，定位代码级故障根源；

支持黑盒日志、系统崩溃瞬间截屏和录像；

[**www.inspur.com**](http://www.inspur.com/)

 **产品规格**

|  |  |
| --- | --- |
| **组件** | **描述** |
| 规格 | 4U机架式 |
| 处理器 | 支持8颗英特尔® 至强®系列可扩展处理器：最多支持28核最高频率3.8GHz三条UPI互连链路，单条链路高速率10.4GT/s最大功率205W |
| 芯片组 | Intel C621/C622/C624 |
| 内存 | 最多支持96条DDR4 2400/2666/2933 MT/s RDIMM/LRDIMM内存，可选支持48条DCPMM内存单颗CPU支持12条DIMM、八颗CPU支持96条DIMMRDIMM/LRDIMM单条内存最大支持64GBDCPMM单条最大支持128GB |
| 存储 | 前置：最大支持24块3.5”硬盘或50块2.5”硬盘，可选支持12块NVME SSD内置：每计算节点支持2块M.2 SSD，系统最大支持4块M.2 SSD |
| 存储控制器 | 内置RAID卡专用插槽，支持标准raid控制器主板集成NVMe控制器接口，可选配Intel NVME RAID Key |
| 网络接口 | 整机支持2块OCP/PHY卡PHY：支持2/4个1/10Gb网口配置OCP：支持1/2个10/25Gb网口配置标准PCIe以太网卡：支持1/10/25/40/100 Gb |
| I/O扩展插槽 | 半高IO配置：最大可扩展14个全长半高标准PCIe插槽，其中2个内置raid卡插槽全高IO配置：最大可扩展10个全长全高标准PCIe插槽，其中2个内置raid卡插槽 |
| 接口 | 前置: 2个USB3.0接口, 1个VGA接口, 1个RJ45串口后置: 2个USB3.0接口, 1个VGA接口, 1个千兆管理网口, 1个BMC串口内置：2个USB3.0接口（每计算节点） |
| 风扇 | 16个热插拔N+1冗余系统风扇 |
| 电源 | 支持4个800W/1300W/1600W铂金/钛金电源，N+N/N+M冗余 |
| 系统管理 | 每计算节点支持1个BMC管理模块，支持IPMI、SOL、KVM Over IP、虚拟媒体等管理特性，支持BMC镜像冗余 |
| 操作系统 | 支持Windows Server/ Red Hat/ SUSE/ CentOS/ Debian/ XenServer/ Oracle Linux/ ESXi/Ubuntu等 |
| 尺寸 | W（宽）448mm；H（高）175.5mm；D（深）800mm |
| 重量 | 满配<110kg，具体详情请参考技术白皮书 |
| 工作温湿度 | 0℃-45℃/0%-93%因配置而异，具体详情请参考技术白皮书 |